



El NPM-W2 combina la colocación precisa de componentes, la inspección precisa de SPI y AOI y la dispensación de adhesivo reproductivo en una solución de alta velocidad.

NPM-W2

Una mayor productividad y calidad gracias a la integración de los procesos de impresión, colocación e inspección hacen del NPM-W2 una de las soluciones de recogida y colocación más flexibles y versátiles del mercado.

Key Features

Equipado con un cabezal de 12 boquillas y puede colocar 38.500 componentes

Inspección automática de depósitos de soldadura y componentes según los datos de producción

Compatible con el mecanismo de descarga HDF, que garantiza una dispensación sin contacto de alta calidad con un dispensador de válvula de tornillo



NPM-W2

<https://latam.connect.panasonic.com/co/es/productos/smart-factory-solutions/npm-w2>

PCB dimensions (mm)	Single-laneBatch mounting2-positin mountingDual-laneDual transfer (Batch)Dual transfer (2-position)Single transfer (Batch)Single transfer (2-position)
Placement Head max Speed	38 500cph (0.094 s/ chip)
Placement Head Placement Accuracy (Cpk≥1)	±40 μm / chip
Placement Head	16 / 8 / 3
Component dimensions	03015 chip ~ L 120 × W 90 × T 30 / T 40 or L 150 × W 25 × T 30 / T 40
PCB Transfer Lane	Single/Dual
Component Supply	Taping/Stick/Tray
Maximum number of components supply (Tape Width: 4 mm, 8 mm calculation)	120
Number of heads	2
Footnote Description	*The above specifications are standard specifications. Please contact us for details, as the product may differ depending on usage conditions, etc.